

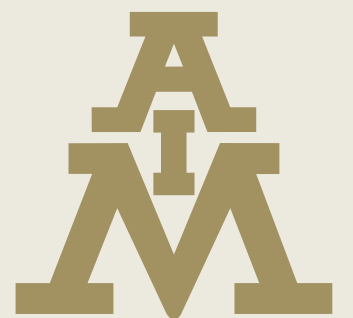
# USO DE PAPEL FAX TÉRMICO (TFP) PARA EVALUAR LA PENETRACIÓN DE FLUX

## ¿CÓMO UTILIZAR EL TFP PARA EVALUAR LA PENETRACIÓN DE FLUX DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN DE FLUX POR ESPRAY?

- ★ **Antes de comenzar la prueba, realice una limpieza y servicio completo al equipo que se utilizará para la aplicación de flux**  
**Asegúrese de que el flux que se va a utilizar sea de un recipiente sellado y sin usar**
- **Usando guantes, corte un trozo del papel fax y alinéelo con el área que será probada**
- **Use la segunda PCB con las mismas dimensiones y coloque el papel fax entre ellas**  
\*Si no dispone de una segunda PCB, se puede utilizar cinta Kapton pero los resultados no serán precisos
- **Colocar en los bordes de las PCBs la cinta Kapton, asegúrese de no interferir con las áreas de prueba**  
\*El papel fax térmico (TFP) puede ser útil para calcular la ubicación y la cantidad de flux aplicado en una PCB durante un proceso de soldadura por ola
- **Realice la prueba del ensamblaje a través del proceso de aplicación de flux**
- **Retire el ensamblaje que está en prueba de la máquina por ola, después de la aplicación del flux y antes de la etapa de precalentamiento**
- **Separe las dos tablillas y retire el papel fax de prueba**
- **Las manchas oscuras en el área de prueba son evidencia del contacto con el flux**  
\*Si no hay un patrón oscurecido, revise la configuración del ensamblaje de prueba para ver si está desalineado
- **Registre los ajustes en el proceso de aplicación de flux directamente en el TFP**  
\*Incluya el tipo de flux y el número de lote, la presión, la velocidad de desplazamiento, los cambios/tipo de boquilla y todos los demás valores que se pueden configurar

Para descargar u obtener más información visite

[www.aimsolder.com](http://www.aimsolder.com)



Solder plus Support